



平成 29 年 8 月 24 日

各 位

会 社 名 セイコーホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 吉伸
(コード番号 8050 東証第 1 部)
問合せ先 総務部長 田嶋 直樹
(TEL 03-3563-2111)

連結子会社の商号変更に関するお知らせ

当社の連結子会社であるエスアイアイ・セミコンダクタ株式会社は、下記のとおり商号変更を行いますので、お知らせいたします。

記

1. 当該子会社の概要

- (1) 現 商 号 : エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社
- (2) 所 在 地 : 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 8 番地
- (3) 代 表 者 : 代表取締役 石合 信正
- (4) 事業内容 : 半導体製品の開発・製造・販売
- (5) 資 本 金 : 9,250 百万円

2. 新商号

エイブリック株式会社 (英文名 ABLIC Inc.)

3. 商号変更の理由

当該子会社は、平成 27 年 9 月に当社の連結子会社であるセイコーインスツル株式会社 (代表取締役社長: 村上 斉、本社: 千葉県千葉市/以下、SII) の子会社として設立され、平成 28 年 1 月に株式会社日本政策投資銀行 (代表取締役社長: 柳 正憲、本社: 東京都千代田区/以下、DBJ) の共同出資を受け、SII の半導体事業を継承する形で事業を展開・発展させてきました。

現在は、SII がエスアイアイ・セミコンダクタ株式会社の 60%持分を、DBJ が 40%持分を保有しておりますが、平成 30 年 1 月以降に SII が DBJ に対して 30%持分を譲渡し、DBJ が 70%持分を保有することを予定しています。これを機にアナログ半導体の専門メーカーとして一層の成長拡大を目指すべく、商号を変更することにいたしました。

4. 商号変更日

平成 30 年 1 月 5 日 (予定)

以上